

前言

2015年10月中旬，人們正享受著秋冬時節的宜人氣候，矽品精密工業股份有限公司（以下簡稱矽品）創辦人林文伯卻在辦公室內陷入苦思，他不解於席捲全球企業間的併購浪潮怎會朝他迎面撲來？矽品才剛要朝著下一個30年邁進，卻被同為積體電路(integrated circuit, IC)封裝測試（以下簡稱封測）廠的日月光集團（以下簡稱日月光）視為併購目標，究竟他該採取什麼對策才不會失去主導矽品的權力呢？

近幾年全球併購交易金額出現往上攀升的趨勢（如圖 1 所示），全球封測產值又在 2014 年經過一波高點之後，出現下滑

且負成長的跡象（如圖 2 所示）。2015 年中旬，矽品股價隨著台灣證券交易指數大跌，創下 32.5 元的新低點，日月光便瞄準此時，宣布將在 8 月 24 日至 9 月 22 日，以每股 45 元的價格公開收購矽品普通股，同時用每一單位 225 元新台幣的美元現金做為對等價格，大量買進矽品流通在外的美國存託憑證，合計股數約占矽品發行的全部普通股 24.99%（楊曉芳，2015）。

為了反擊日月光突如其來的購股邀約，矽品尋求知名電子精密儀器代工生產(original equipment manufacturer, OEM)廠商——鴻海科技集團（以下簡稱鴻海）的協助，做為驅趕敵意併購者的“white knight”²；只是若想與鴻海組織聯盟，需先增資後換

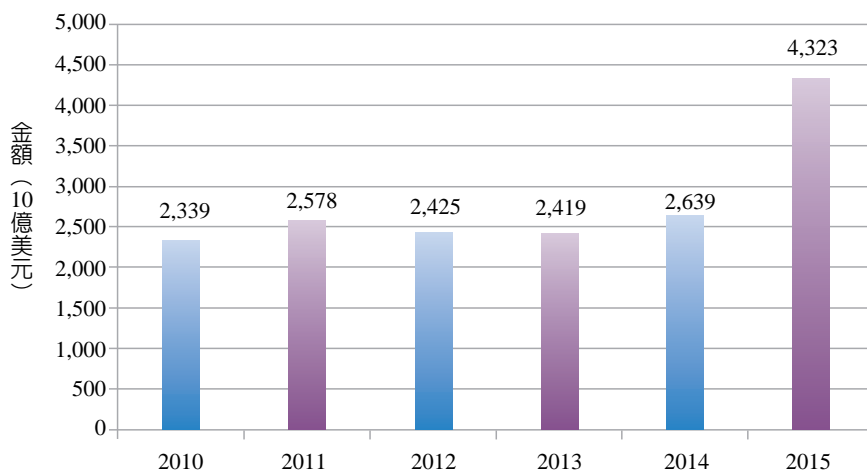


圖 1 2010~2015 年全球併購交易金額統計

資料來源：引自 2016 海外併購白皮書，台灣併購與私募股權協會、資誠聯合會計師事務所、普華國際財務顧問股份有限公司，2016，取自 <https://www.pwc.tw/zh/publications/topic-invest/assets/2016-taiwan-mna.pdf>

2 “white knight”為一種反敵意併購的策略。當企業面對敵意併購的危機，可找來支持現任經營者的友好第三方，同樣對己方提出收購邀約，提高欲達成敵意收購需耗費的成本，讓敵意併購者知難而退。採用該策略時需注意避免用過分優待的條件換取幫助，以免導致未能獲得股東支持。

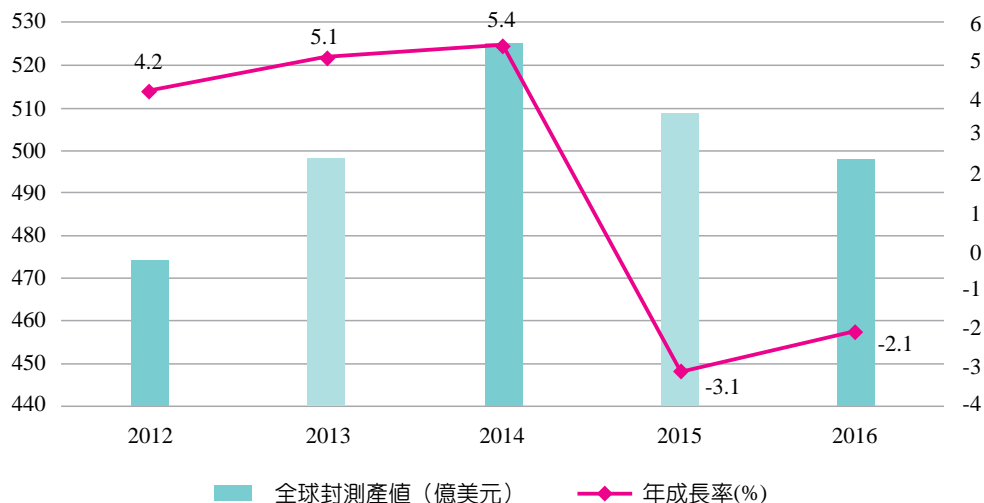


圖 2 2012~2016 年全球封測產值與成長率

資料來源：引自 TrendForce：2016 年晶圓代工產值僅成長 2.1%，IC 封測產值微幅下滑 0.5%，黃志宇，2015，取自 <https://press.trendforce.com.tw/press/20151210-2978.html>

股才能完成合作，這將導致股本膨脹、稀釋股份（楊曉芳、涂志豪、鄭淑芳，2015），造成現任股東擔憂自身權益不受重視，眾多質疑聲始終未獲平息，果然，同年10月15日臨時股東會的投票結果，說明矽品的驅敵策略沒有受到股東們的青睞。

牆上時鐘的滴答聲響聽在林文伯的耳裡，每一聲都像奪魂的樂音，他沮喪於和鴻海共組策略聯盟的計畫無法如願，而公司未來制定決策還得受制於日月光，矽品應如何與既是競爭者又是最大股東的日月光進行協商？獨自坐在辦公桌前，林文伯得先暫緩之前萌生的退休計畫（林資傑，2015c）。爲了信任他的員工與股東們，他勢必得打起精神，認真地思索這一場博弈之棋該如何進行攻防。

IC 封測產業

產業概況

半導體製程產業鏈內，從上游到下游可以分爲IC設計、晶圓代工（晶圓製程、晶圓測試、封裝），以及晶圓完整切割後與IC板的封裝和測試階段。其中，封裝階段主要是將IC晶片安裝上外殼，晶片外的這層保護裝置不僅有固定、密封與保護等功能，同時也增強了導熱性能，且外殼裝置也是連接晶片內部和外部電路的溝通橋梁，即封裝外殼的導線連接到晶片接點上的導線，電路板上的導線又與各晶片上的線路連接，使得零件之間可以建立連結。所以，封裝製程所發揮的作用是IC代工中相當關鍵的一環。目前台灣的幾間封測大廠包括：產值在世界排名居於第一與第三